ピクセル型STEM検出器「4DCanvas[™]」 により取得された応用データ紹介



はじめに

走査型透過電子顕微鏡(STEM)では、集束した電子線プローブを 試料上でスキャンさせる。従来型のSTEM検出器では、回折パ ターン中の強度分布は検出器面上で積分されていたため、散乱 角や散乱方向に依存した詳細情報を引き出すことができなかった。 ピクセル型STEM検出器では、CCDやCMOS等のイメージセン サーで2次元STEMプローブ位置ごとの回折パターンを2次元画像 として記録し4次元データとして扱うことで、従来のSTEM検出器で は失われていた情報を有効利用することが可能となる。今回はピ クセル型STEM検出器「4DCanvas™」を用いて取得したデータ例 を紹介する。

応用データその2: 試料中の電場マップ作成

試料中に電磁場が存在していれば電子線は偏向作用を受けるが、STEM検出器面 上ではこの偏向は回折パターンの位置シフトに相当する。各プローブ位置におけ る回折パターンの重心を計算することによりこの位置シフトを検出することがで き、試料中の電磁場ベクトルに変換することができる。

・試料:GaAs中のPNジャンクション
・加速電圧:200 kV (JEM-ARM200F)
・STEM像のピクセル数:512×512

・4DCanvas™のピクセル数 : 264 × 264 (no bin) ・フレームレート : 1,000 fps (dwell time: 1 ms) ・データ取得時間 : 262 s

JEOL

高速ピクセル型STEM 検出器「4DCanvas™」

試料上のSTEMプローブの移動とセンサーの読 み出しタイミングを同期させることにより、通 常のSTEM像取得と同様の操作で4次元データを 容易に取得することができる。本検出器のイ メージセンサーにはpnCCD(PNDetector GmbH 社製)が採用されている。画素数は 264×264 pixelsであり、STEM検出器として用 いるには十分多い。pnCCDはシンチレーターを 介さない直接電子検出型のCCDであり、入射電 子1個あたりの信号が読み出しノイズに比べて高 く、また量子効率がほぼ100%であるため、入射 電子1個の信号を確実に記録することができる。 読み出し速度は最速で<u>7,500 fps</u>で、高速な画像 取り込みが可能となっている。







4次元データから作成された電場マップ。色相と彩度はそれぞれ 電場の向きと強度と表している。画像中心を縦方向に走る紫色の 線がPNジャンクションが存在している部分である。上部のSIMS プロファイルはGaAs中のドーパント(SiとZn)濃度を示している。 ドーパント濃度が変化している位置にも微小な電場(マップ中の 緑線)が生じていることが分かる。

pnCCDの仕様

Detector type	back-illuminated direct electron detection CCD
Pixel size	48 × 48 um ²
Number of pixels	264 × 264 pixels
Frame rate*	2,000 fps (full frame readout) (264 x 264)
(degree of binning)	4,000 fps (2-fold binning) (264 x 132)
(number of pixels)	7,500 fps (4-fold binning) (264 x 66)
SNR	typ. 300:1
Quantum efficiency	typ. > 99% @ 20 kV ~ 300 kV
Operation modes	Single electron mode (best at very low intensities)
	Imaging mode (standard mode for imaging)
	Anti-Blooming mode (reduces overflow at high
	intensities)
Radiation hardness	> 4 × 10 ¹⁷ electrons/cm ² @ 200 kV



4DCanvasの外観

*高速化オプションを付けた場合

応用データその1: 仮想絞りによる暗視野STEM像作成

回折パターン中に仮想的な絞りを配置することで、様々な種類の明/暗視野STEM 像を作成することができる。ここの例では、ω相の析出物を含むAI合金から4次 元データを取得し、析出物が方向ごとに別々のSTEM像として可視化されている。

・試料:AI合金
・加速電圧:200 kV (JEM-ARM200F)
・STEM像のピクセル数:512×512

・4DCanvas™のピクセル数 : 264 × 264 (no bin) ・フレームレート : 1,000 fps (dwell time: 1 ms) ・データ取得時間 : 262 s



応用データその3: タイコグラフィーによる高S/N位相像再構成

タイコグラフィーとは試料の位相像を再構成する画像処理法であり、4次元デー タセットに対して空間周波数領域でフィルタリングを行うことにより、高S/N、 高コントラストの位相像を再構成することができる。フィルタリングは全ての空 間周波数に対して行われるため、結晶性の試料だけでなくアモルファス試料に対 しても適用可能である。

・試料:2層グラフェン
・加速電圧:80 kV (JEM-ARM200F)
・STEM像のピクセル数:256×256

・4DCanvas™のピクセル数: 264 × 66 (4-fold bin) ・フレームレート: **4,000 fps** (dwell time: 250 us) ・データ取得時間: **16 s**





①ノイズ成分除去のため、透過波と回折波の重複領域以外の領域の振幅をゼロにする。

従来型STEM検出器で得られたADF像。格子欠陥 の存在は確認できるが、詳細な構造は可視化さ ADF像と同時取得した4次元データから再構成したタイコグラフィー位相像。S/Nが向上したこと

②重複領域の一方に位相πを加え位相を揃れていない。 えることで位相コントラストを得る。 で格子欠陥の詳細な構造を明瞭に確認すること ができる。

まとめ

高速ピクセル型STEM検出器「4DCanvas[™]」により、以下に 示すように従来のSTEM検出器では得ることのできなかった 新しいタイプのSTEM像を得ることが可能になった。

✓回折パターン中に仮想的な絞りを配置することにより、AI 合金中ω相の析出物を方向ごとに別々のSTEM像として可視 化することができた。

✓GaAs中のPNジャンクション由来の電場を可視化することができた。

✓タイコグラフィーにより2層グラフェン中の格子欠陥を明瞭 に観察することができた。